



「次世代モビリティに求められるパワー半導体デバイス」

◇ 日時: 2019年11月15日(金) 13:00~17:40

◇ 場所: IMY(アイ.エム.ワイ)ビル 3階大会議室、〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3-7-14
(地下鉄 千種駅から徒歩2分 <http://kaigi-nagoya.com/access.html>)

パワー半導体の重要な出口である電動化応用(自動車・航空機)について、ユーザーサイド(自動車部品メーカーのパワー回路・システム設計技術者、大学のパワーシステム研究者)から、パワー半導体への期待及び求められる特性についてご講演頂く。また、デバイス側から電動化に向けた現状の取り組みをご講演頂き、両者で次世代モビリティに向けたパワー半導体の方向性について議論する。

..... プログラム

開会のあいさつ 13:00~13:10

電動化社会を牽引するパワーエレクトロニクス 13:10~13:45
中津 欣也 (株式会社 日立製作所)

次世代モビリティのための旅客機と電動化システムの将来 13:45~14:20
大依 仁 (株式会社 IHI)

走行中ワイヤレス給電に対応したインホイールモータの開発 14:20~14:55
藤本 博志 (東京大学)

次世代パワー半導体を活かす車載電力変換器 14:55~15:30
木村 友則 (株式会社 デンソー)

休憩 15:30~15:50

xEVに適した最新 Si-IGBT チップ技術 15:50~16:25
新田 哲也 (三菱電機 株式会社)

xEV パワートレイン用パワー半導体素子の開発状況 16:25~17:00
大月 正人 (富士電機 株式会社)

スケーラビリティを実現するための半導体パワーモジュール(HybridPACK シリーズ) 17:00~17:35
竹谷 英一 (インフィニオンテクノロジーズジャパン 株式会社)

閉会のあいさつ 17:35~17:40

.....
■参加受付: WEB 参加受付システム([ここをクリック*](#))から参加登録をお願いします。11月1日(金)の登録状況でテキスト印刷部数を決定しますので、以後の登録ではテキストを当日お渡しできない可能性があります。

*本案内が印刷物の場合、<https://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai16.pdf> よりアクセスして下さい。

■参加費: (テキスト代・消費税込)当日会場にてお支払いください。

先進パワー半導体分科会会員* 2,000円、分科会学生会員 1,000円、一般 4,000円、一般学生 1,000円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

問合せ先:

服部 佳晋(豊田中央研究所)	TEL: 0561-71-7766	e-mail: y-hattori@mosk.tytlabs.co.jp
斎藤 順(トヨタ自動車)	TEL: 0565-46-3397	e-mail: jun_saito@mail.toyota.co.jp
多留谷 政良(三菱電機)	TEL: 096-242-6170	e-mail: Tarutani.Masayoshi@da.MitsubishiElectric.co.jp
五十嵐 周(応用物理学会事務局)	TEL: 03-3828-7723	e-mail: igarashi@jsap.or.jp